

产品规格书

球形氧化铝产品规格书

产品介绍

球形氧化铝是以低钠氧化铝为原料,采用火熔法生产球形氧化铝粉。球形导致低比表面积和高流动性。同时,球形氧化铝粉末具有高导热性和低吸油率。广泛用作电子产品中的导热填料、环氧树脂、陶瓷烧结中的隔热介质、热喷涂粉末等。

球形氧化铝粉末的特点:

1. Al₂O₃ 纯度高达 99.5%以上, Na₂O 含量低达 0.1%以下。
2. 球化率高, 流动性好, 研磨不损伤。
3. 吸油率低, 适用于填充材料。
4. 低 BET 表面积和与树脂混合的低粘度。
5. 导热系数高于角形氧化铝。

化学成分:

成分	保证值	典型值
Al ₂ O ₃ (%)	99.5%	99.94
SiO ₂ (ppm)	500	373
Fe ₂ O ₃ (ppm)	200	120
Na ₂ O (ppm)	200	107

物理性能:

牌号	比表面积 (m ² /g)	比重 (g/cm ³)	电导率 (us/cm)	PH 值	水分 (%)	成球率 (%)	D10 (um)	D50 (um)	D90 (um)
HGSA01	1.69	3.71	6.07	7.79	0.03	98	0.58	1.03	2.14
HGSA02	1.27	3.72	5.40	7.70	0.03	96	0.69	2.18	5.24
HGSA05	0.36	3.74	5.65	7.90	0.03	98	2.54	5.52	9.09
HGSA10	0.17	3.76	4.05	7.62	0.03	98	4.18	10.03	18.46
HGSA15	0.14	3.86	1.83	7.80	0.03	98	7.03	15.11	24.06
HGSA20	0.11	3.80	6.87	7.80	0.03	98	10.5	20.8	37.24
HGSA30	0.10	3.76	7.95	7.40	0.05	96	16.88	30.52	48.87
HGSA40	0.07	3.81	4.65	7.45	0.03	98	23.77	41.54	66.44
HGSA70	0.05	3.87	6.18	7.70	0.03	96	44.32	71.54	106.5
HGSA90	0.06	3.88	8.15	7.35	0.05	95	55.23	87.96	134.92
HGSA120	0.06	3.82	2.60	7.46	0.03	96	90.95	122.39	172.72



用途：

1. 半导体和电子领域用的导热灌封胶、导热硅胶，导热胶带等
2. 陶瓷烧结隔粘粉，陶瓷元件隔热粉和耐火介质
3. 各种树脂塑料的填充材料。特别适用于提高硅橡胶、环氧树脂、各种工程塑料等的导热性和表面硬度。
4. 烧结陶瓷造粒粉
5. 研磨和抛光
6. 热喷涂材料